

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Type	Arbeider med	Pakkeantall	Dybde	Bredde
---------------	------	--------------	-------------	-------	--------

24830-005	Varmeleder	Tilfeller	1	22 mm	22 mm
-----------	------------	-----------	---	-------	-------

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE